

Ik wil graag deelnemen aan de
 Q.P.I. Technologie meeting
A PCB technology catch up
"Bijpraten over printplaten"
 Op 15 maart 2012
 High tech Campus Eindhoven

Naam:

Bedrijf:

Functie:

Tel:

Email:

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, indien er meer inschrijvingen zijn is het tijdstip van aanmelding bepalend. Bij verhindering dit zeer graag laten weten 0492-590059

De inschrijving wordt altijd bevestigd.

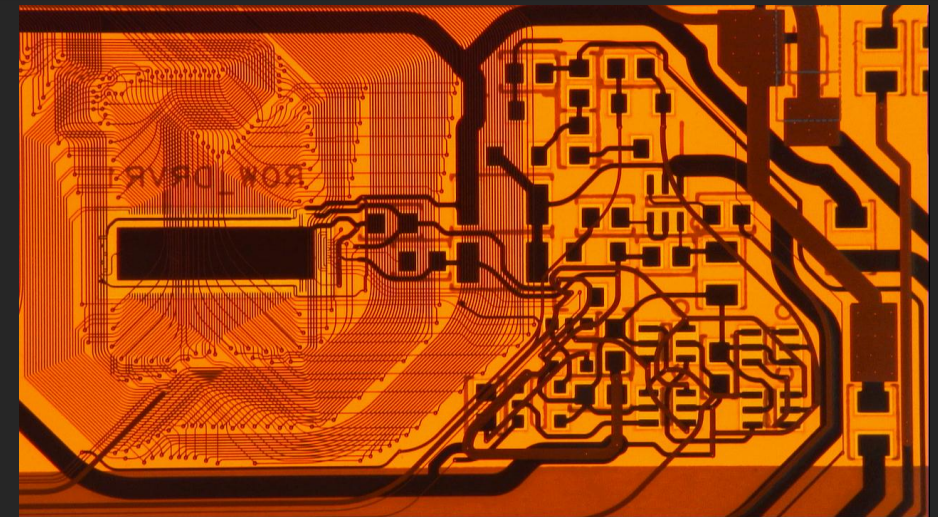
Voor meer informatie:

Q.P.I. Circuits B.V.
 5705 CS Helmond
 Nederland

Tel.: +31 (0)492 590059
 Email: qpiinfo@qipigroup.com
WWW.QPIGROUP.COM



Your complete solution provider for
 Product development and PCB-design



2 layer Flex circuit with 40 micron pitch

Q.P.I. Technology meeting
A PCB technology catch up

- PCB technology
- PCB manufacturing technology
- PCB materials

15 March 2012

High tech Campus Eindhoven



15 maart 2012

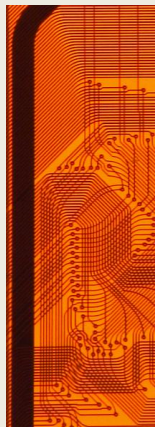
Q.P.I. Technologie meeting

High tech Campus Eindhoven
The Strip Conference Centrum

„A PCB technology catch up“



- PCB technology
- PCB manufacturing technology
- PCB materials



Hoe krijg je de benodigde elektronica in de beschikbare ruimte, hoe zorg voor betrouwbare aansluitingen, wat zijn de beste keuzes voor wat betreft materialen. Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er voor de fabricage van printplaten. Wat is de roadmap van de technologie aanbieder, maar evenzo wat is de roadmap van de hightech industrie. Zomaar een aantal vragen waar ontwikkelaars, systemintegrators en purchase managers mee geconfronteerd worden. Daarom organiseert Q.P.I. op 15 maart 2012 op de high tech campus een technologie dag met het thema „Bijpraten over printplaten“



Your complete solution provider for
Product development and PCB-design

Voorlopige Agenda

Introduction Welkom, 10:00hr

- Q.P.I. De PCB wereld volgens Q.P.I.
De Q.P.I. Group in 2012
Q.P.I. Laboratorium
Roadmap technologische ontwikkelingen
Warmteontwikkelingsbeheersing
Gebruik van keramiek als printplaat materiaal
Fine Pitch VHDI, wat zijn de design rules
Printplaat toepassingen in vacuüm
- ASML Roadmap
- Endicott System in Package door verregaande integratie kunnen PCBs veel kleiner worden
- Eltek System Integration met behulp van Flex rigids
- Arlon Nieuwe materialen voor printplaat toepassingen
- Camtek Nieuwe productie technologie voor het aanbrengen van soldermask, wat zijn de mogelijkheden
- Q.P.I. Library beheer voor EDA. Standaardiseren levert kostenbesparing, doorlooptijd vermindering en verhoging van flexibiliteit op.